佛山市南海区科学技术局关于《佛山市南海区半导体与集成电路产业扶持办法（征求

意见稿）》公众意见采纳情况的公告

我局制定的《佛山市南海区半导体与集成电路产业扶持办法（征求意见稿）》征求公众意见阶段已经结束，现将公众意见的采纳情况公布如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位**  **名称** | **意见\建议** | **是否采纳** | **说明** |
| 佛山华智新材料有限公司 | 一、第四条 支持新产品研发与首层 增加：支持半导体企业开展封装测试新工艺、载板新材料等新技术、新工艺和新产品研发，对于研发或首次量产，按照其研发投入的30%给予补助。 | 不  采  纳 | 办法中第二条、第三条、第四条已经对企业研发进行了奖补 |
| 二、第七条 支持产业链协同 增加： 支持区内产业链上下游企业开展技术合作和联合技术攻关，按照技术合作金额的30%给予补贴。 | 不  采  纳 | 联合技术攻关可以申请我区“揭榜挂帅”等项目获得奖补 |
| 广东希荻微股份有限公司 | 1. 章条编号：第二条 支持产品研发流片 意见及建议：   1.建议扶持对象扩大范围至企业子公司或分公司。 2.建议提高年度最大补助总额至800万元。 理由或依据：由于半导体行业的原因，为了便于与境外的供应商和客户交易，大部分国内的半导体公司一般会在香港设立采购销售主体，因此相关的大部分流片、掩模板的费用发生在香港子公司，便于通过香港公司支付境外美元的流片和掩模板等费用，但实际研发活动发生在内地，因此建议扶持对象扩大范围至企业的子公司等。 | 不  采  纳 | 扶持对象明确要求工商注册地在南海区范围内 |
| 二、章条编号：第三条 支持购买EDA软件和IP 意见及建议：1.建议提高年度最大补贴总额至500万元。理由或依据：随着公司发展壮大，研发项目增多，相对地对EDA设计工具软件的数量需求激增，现每年购买EDA设计工具软件的费用高达千万元以上。 | 不  采  纳 | 经咨询专业机构和对比其它地区的扶持政策，该处奖励300万元是比较合理的平衡点 |
| 三、章条编号：第四条 支持新产品研发与首次量产封测、载板 意见及建议： 1.建议分别提高该两处年度最大补助总额至500万元和300万元。 理由或依据：芯片设计企业测试相关费用含探针卡，PCB板等采购费用高达千万元每年，而且随着业务规模的扩张，相关费用会持续增加。 | 不  采  纳 | 经咨询专业机构和对比其它地区的扶持政策，该两处分别奖励200万元、100万元是比较合理的平衡点 |
| 四、章条编号：第八条 支持人才引进和培养 意见及建议： 1.建议提高生活补助标准：本科生3600元/人，硕士生5400元/人，博士生9000元/人。 理由或依据：由于芯片产业处于高景气期，芯片人才的薪酬已大幅提高，一般一个新的硕士毕业生的年度薪酬在30万元-50万元之间，要解决芯片人才到本地就业和生活，建议加大生活补贴的支持，这有望大力吸引优秀的半导体人才齐聚南海发展就业，在南海安居乐业。 | 不  采  纳 | 建议中生活补助的标准已超过佛山市相关人才政策的标准。根据《中共佛山市委关于加强党对新时代人才工作全面领导进一步落实党管人才原则的意见》，各区人才政策要对接市级人才政策，不得另起炉灶、另搞一套。 |
| 五、其他意见及建议：1. 希望能提高补助核定的频次，加快补助资金的到位，例如：每季度或每半年申报一次，在申报通过的下月就发放补贴。 理由或依据：由于集成电路企业研发成本较高，补贴能够尽早到位，对于企业的研发和经营都产生更积极的影响，这有利于吸引更多集成电路设计企业过来南海创业。 | 采  纳 | 在实施细则中考虑 |
| 广东中科半导体微纳制造技术研究院 | 一、《办法》第二条，建议调整为“在南海区注册的半导体企业，其用于研发的试验晶圆片，可享受最高不超过小试流片直接费用80%、工程片试流片与掩膜版制作（Full Mask）加工费30%的补助。对硅基工艺线宽小于130nm（含）、化合物与宽禁带半导体等工艺，在以上标准基础上分别提高10个百分点，即小试流片直接费用按照不高于90%进行资助，工程片试流片按照不高于其加工费40%进行资助。鼓励企业利用本地平台开展小试及中试，在南海区内平台开展小试研发流片的，按照直接费用不高于90%进行资助，工程片试流片按照不高于其加工费50%进行资助。每个企业年度补助总额不超过500万元。” | 不  采  纳 | 奖励范围过广 |
| 二、《办法》第四条，标题建议调整为“支持新产品研发与首次量产外延、封测、载板”。 | 采  纳 | 已在扶持办法中修改 |
| 三、《办法》第四条，内容建议调整为“对半导体企业利用第三方外延、封装、载板产线开展新产品研发或首次量产，按产首次量产或新产品研发外延、封装测试、载板费用的50%分别给予补助；对采用南海区内第三方外延、封装、载板产线开展新产品研发或首次量产，则按费用的70%给予补贴。每个企业年度补助总额不超过200万元。……” | 采  纳 | 已在扶持办法中修改 |
| 四、《办法》第八条，建议将扶持对象由“半导体企业”扩展至“半导体企事业单位”。 | 不  采  纳 | 事业单位已享受财政扶持 |
| 五、《办法》第八条，第四段内容建议调整为“鼓励建设集成电路公共职业技能培训平台。支持企事业单位与高等学校建立联合培养机制，共建集成电路学生实习实践教学基地；专科及以上学历学生在基地实习实践不少于1个月的，按照专科生800元/月、本科生1200元/月、硕士生1800元/月、博士生3000元/月标准对学生给予补贴。” | 部  分  采  纳 | “鼓励建设集成电路公共职业技能培训平台。支持企业、科研平台与高等学校建立联合培养机制，共建集成电路学生实习实践教学基地；专科及以上学历学生在基地实习实践不少于1个月的，按照每人800元/月标准对学生给予补贴。” |

佛山市南海区科学技术局

2022年6月27日